

● DFN1515-6A 許容損失

DFN1515-6A パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：銅箔 4 層基板 40mm×40mm (片面 1600mm²)

に対して銅箔面積

1 層目：約 50%_放熱板と接続有

2 層目：約 50%_放熱板と接続有

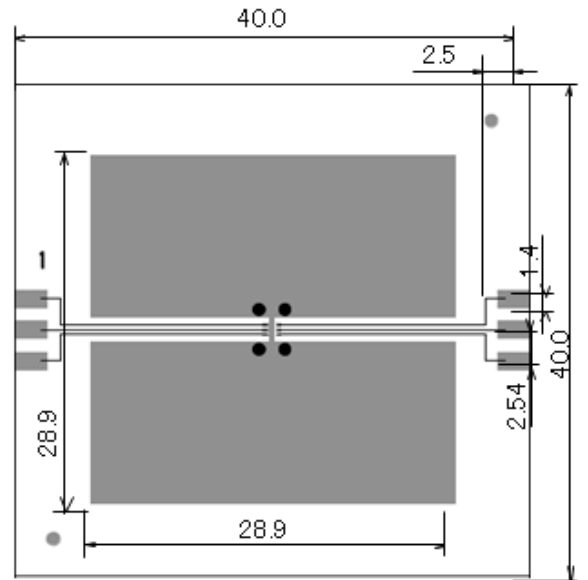
3 層目：約 50%_放熱板と接続有

4 層目：約 50%_放熱板と接続有

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4 個

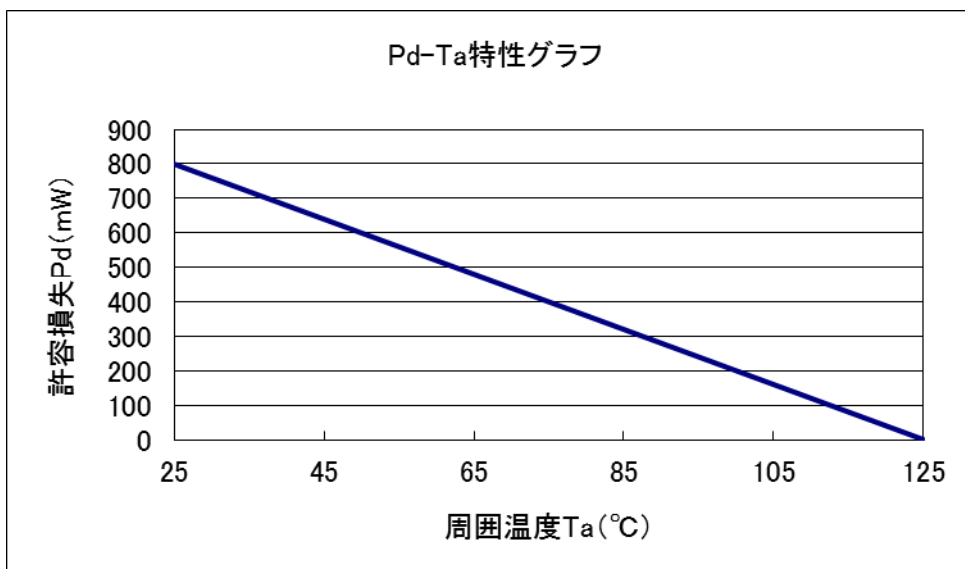


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度($^{\circ}\text{C}$)	許容損失 P_d (mW)	熱抵抗($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
25	800	125.00
85	320	
125	0	



● **DFN1515-6Aパッケージ許容損失 ※T_{imax}=150°C**

DFN1515-6Aパッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 環境条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pbフリーはんだ

実装基板: 銅箔4層基板40mm×40mm(片面1600mm²)

に対して銅箔面積

1層目: 約50%_放熱板と接続有

2層目: 約50%_放熱板と接続有

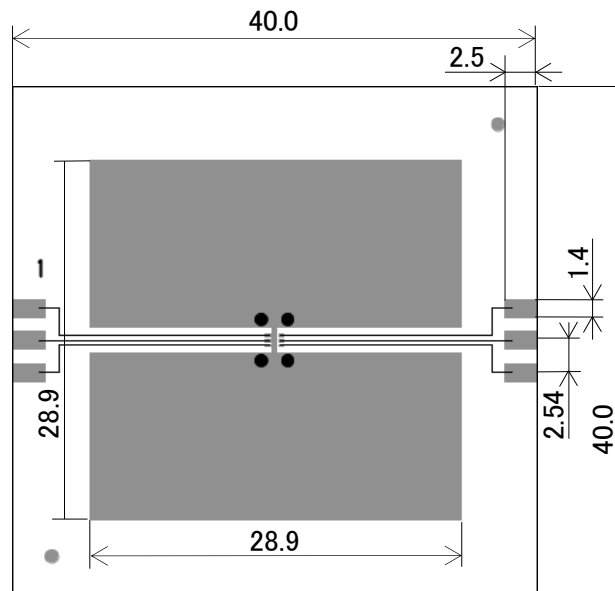
3層目: 約50%_放熱板と接続有

4層目: 約50%_放熱板と接続有

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性

基板実装(T_{jmax} = 150°C)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)		θ _{ja} (°C/W)
	T _a max=125°C	T _a max=150°C	
25	1000	1000	125.00
125	200	200	
150	0	0	

